

전자기판 시장 본격 성장세 진입

일본, FDP 및 디지털 가전 호황 돌입 ... RPC도 서서히 회복케도

일본의 2003년 전자기판 생산액이 1조785억엔으로 전년대비 6.1% 증가한 것으로 나타났다.

양면과 다층의 FPC(Flexible 배선판)가 50%에 가까운 큰 폭의 증가세를 보인 반면, RPC(Rigid 배선판)는 침체가 계속돼 대조적인 결과를 보였다.

2004년에도 전체적으로는 9.2% 증가한 1조1774억엔에 달할 전망이다.

배선판 생산은 2000년 1조4400억엔을 정점으로 침체가 계속되고 있으나 RPC 설비의 아시아 이전이 일단락 되고 FPC가 2002년 후반부터 회복조짐을 보이면서 서서히 회복되는 추세이다.

2003년에는 연초부터 다기능 휴대전화나 플라즈마 TV 등 FPD의 활황, DVD 레코더나 플라즈마 TV 등 디지털 가전의 급성장으로 FPC가 큰 폭으로 증가했다.

일본의 전자기판 생산계획

(단위: 억엔, %)

구 분			2002	2003		2004(E)			
				생 산량	증 감률	생 산량	증 감률		
프린트 배선판	단 면		349.1	340.7	▽2.4	319.6	▽6.2		
	양 면		1,566.9	1,528.7	▽2.4	1,521.3	▽0.5		
	다 층	4층		1,349.0	1,332.7	▽1.2	1,327.9	▽0.4	
		6층		1,101.3	1,083.7	▽1.6	1,089.5	0.5	
		8층		723.5	795.2	9.9	901.3	13.3	
		10층 이상		344.6	349.3	1.4	429.1	22.8	
		소 계		3,518.4	3,560.9	1.2	3,747.8	5.2	
		Buildup	4층		(16.1)	(42.4)	163.0	(63.5)	49.9
			6층		(354.6)	(425.7)	20.1	(512.3)	20.3
			8층		(509.2)	(527.4)	3.6	(601.2)	14.0
			10층 이상		(76.8)	(64.6)	▽15.8	(90.8)	40.4
			소 계		(956.7)	(1,060.2)	10.8	(1267.7)	19.6
	Flexible	단 면		887.0	955.3	7.7	1,055.1	10.4	
		양 면		542.2	805.8	48.6	973.7	20.8	
		다 층		190.7	281.6	47.7	380.0	35.0	
		Buildup		(1.5)	(0.2)	▽90.0	(0.3)	100.0	
		소 계		1,619.9	2,042.7	26.1	2,408.7	17.9	
	Flex-Rigid		40.8	200.6	391.7	268.7	33.9		
	Ceramics		136.1	150.2	10.3	168.8	12.4		
	Metalcore		32.3	33.0	2.3	36.0	9.0		
	기 타		46.5	27.6	▽40.7	27.6	0.1		
	소 계		7,310.0	7,884.4	7.9	8,498.6	7.8		
Module 기판	Rigid 기판		1,827.4	1,847.8	1.1	2,147.0	16.2		
	Tape 기판		674.3	803.3	19.1	928.7	15.6		
	Ceramics 기판		350.0	250.0	▽28.6	200.0	▽20.0		
	Buildup 기판		(1,063.0)	(1,057.9)	▽0.5	(1,388.3)	12.9		
	소 계		2,851.7	2,901.1	1.7	3,275.7	31.2		
합 계			10,161.7	10,785.5	6.1	11,777.3	9.2		

양면 FPC는 전년대비 48.6% 증가한 805억엔, 다층 FPC는 47.7% 증가한 281억엔에 달했다.

FPC 전체적으로는 26.1% 증가해 처음으로 2000억엔을 돌파하면서 2042억엔을 기록했다. Flex-Rigit 배선판도 큰 폭으로 증가해 5배에 달하는 200억엔을 기록하는 등 휴대전화나 컴퓨터의 모바일용 배선판도 급증했다.

RPC는 단면, 양면 모두 마이너스로 다층기판도 4층, 6층 모두 마이너스 성장을 기록했다. 이에 따라 생산액이 3560억엔으로 1.2% 증가하는 수준에 그쳤다.

Buildup 기판은 다기능 휴대전화나 IC 카드 등이 호조를 보임에 따라 10.8% 증가한 1060억엔에 달했다. 또 Package 실장용의 모듈기판은 초박형 테이프기판이 19.1% 증가한 803억엔을 기록했다.

2004년 RPC는 2003년 가을 이후 시세 개선조짐을 보임에 따라 연초에도 출하가 증가하는 등 회복 움직임을 보이고 있다. 또 FPC, Flex-Rigid, Buildup 기판, 모듈기판은 2003년에 이어 호조가 계속돼 2자리수 성장이 예상된다.

<화학저널 2004/06/18>